



**上海证券**  
SHANGHAI SECURITIES

# 英伟达业绩超预期，人工智能有望成为 拉动晶圆代工复苏核心驱动力

——电子行业周报（2024.05.20-2024.05.24）

## 增持（维持）

行业： 电子  
日期： 2024年05月27日

分析师： 马永正  
Tel: 021-53686147  
E-mail: mayongzheng@shzq.com  
SAC 编号: S0870523090001  
联系人： 陈凯  
Tel: 021-53686412  
E-mail: chenkaishzq@shzq.com  
SAC 编号: S0870123070004  
联系人： 杨蕴帆  
Tel: 021-53686417  
E-mail: yangyunfan@shzq.com  
SAC 编号: S0870123070033

### 核心观点

#### 市场行情回顾

过去一周（05.20-05.24），SW 电子指数下跌 3.49%，板块整体跑输沪深 300 指数 1.41 pct，从六大子板块涨跌幅数据来看，消费电子、元件、其他电子 II、光学光电子、电子化学品 II 以及半导体的涨跌幅分别为 -2.32%、-2.45%、-3.11%、-3.47%、-3.89%、-4.28%。

#### 核心观点

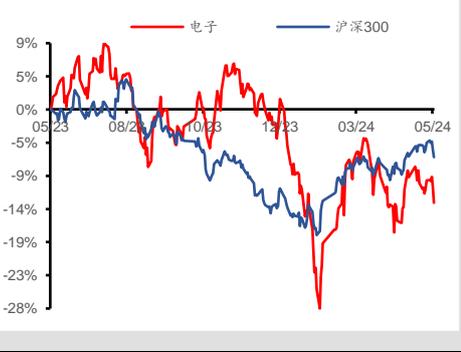
**晶圆代工短期调整不改长期复苏趋势，人工智能将是晶圆代工的主要增长动力。**5月22日，据 Counterpoint 报告显示，2024 年第一季度全球晶圆代工营业收入环比下滑 5%，但同比增长 12%，当季的营收调整除季节性影响外，非 AI 半导体需求复苏放缓也是原因之一。然而摩根大通倾向于认为晶圆代工行业在 2024 年第一季度景气落底，未来随着 AI 需求持续上升、非 AI 需求逐渐恢复，晶圆代工产业将摆脱谷底、转向复苏。从六大晶圆代工企业的具体情况来看：台积电一季度业绩仍高居榜首，份额占比达 62% 超出预期，台积电还将 AI 相关收入年均复合增长率 50% 的持续时间延长至 2028 年。尽管预期 CoWoS 产能到 2024 年底将同比增长逾一倍，但仍无法满足客户强劲的 AI 需求。值得注意的是，由于 AI 芯片的强劲需求，台积电 5nm 产能利用率一直保持强劲。三星为第二大代工厂，份额 13%，其预计随着第二季度需求改善，晶圆代工收入预计将出现两位数百分比反弹。中芯国际在一季度超越格芯、联电成为全球第三大晶圆代工厂，业绩超出市场预期，得益于 CMOS 图像传感器（CIS）、电源管理 IC（PMIC）、物联网芯片和显示驱动 IC（DDIC）等业务增长以及市场复苏。随着客户补充库存需求的扩大，中芯国际预计第二季度将继续保持增长。Counterpoint 表示，进入 2024 年第一季度，已观察到半导体行业显露需求复苏迹象，尽管进展比较缓慢，但经过连续几个季度去库存，渠道库存已经正常化。该机构认为，AI 的强劲需求和终端产品需求复苏，将成为 2024 年晶圆代工行业的主要增长动力。

**英伟达业绩超预期，将全力准备迎接 AI 驱动下“新工业革命”增长机遇。**5月23日，据英伟达财报显示，英伟达 2025 财年第一季度营收为 260 亿美元，较上一季度增长 18%，较去年同期增长 262%；GAAP 净利润为 148.81 亿美元，同比增长 628%，环比增长 21%，对应每股净利 5.98 美元；GAAP 毛利率也由上一季度的 76%，继续上升至 78.4%。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，下一场工业革命已经开始，人工智能将给“几乎各行各业”带来显而易见的生产力增长。对此，英伟达已经在全力准备迎接这一增长机遇。针对 AI 芯片的交付问题，黄仁勋表示，客户就交付系统（的问题）向英伟达施加很大的压力——需求实在太高，超过供应。在诸多领域，存在大约 1.5 万 -2.0 万家生成式 AI 初创公司。它们都在等待成为英伟达的客户，以期通过英伟达芯片来训练模型。英伟达已经变成一个系统供应商，而不仅仅是（局限于 GPU 的）卖家。

### 投资建议

**维持电子行业“增持”评级，我们认为目前电子半导体行业处于周期底部，2024 年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏，同时 IPO 新规下，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。我们当前重点看好：半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低 PE/PEG 的个股，AIOT SoC 芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；模拟芯片建议关注美芯晟和南芯科技；建议重点关注驱动芯片领域峰昭科技和新相微；miniled 电影屏重点看好奥拓电子；半导体设备材料建议重点关注华海诚科和昌红科技；折叠机产业**

### 最近一年行业指数与沪深 300 比较



### 相关报告：

《半导体景气度持续改善，英伟达 GB200 有望拉动芯片测试与玻璃基板市场》

——2024 年 05 月 20 日

《M4 处理器赋能新款 iPad Pro，全球智能手机市场加速复苏》

——2024 年 05 月 13 日

《材料专题之 OCA 光学胶：柔性&车载显示推动市场成长，国产替代任重道远》

——2024 年 05 月 10 日

链重点关注统联精密；建议关注军工电子紫光国微和复旦微电；建议关注华为供货商汇创达。

■ **风险提示**

中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。

## 目 录

<b>1 市场回顾</b> .....	<b>4</b>
1.1 板块表现 .....	4
1.2 个股表现 .....	5
<b>2 行业新闻</b> .....	<b>6</b>
<b>3 公司公告</b> .....	<b>8</b>
<b>4 风险提示</b> .....	<b>9</b>

### 图

图 1: SW 一级行业周涨跌幅情况 (05.20-05.24) .....	4
图 2: SW 电子二级行业周涨跌幅情况 (05.20-05.24) .....	4
图 3: SW 电子三级行业周涨跌幅情况 (05.20-05.24) .....	5

### 表

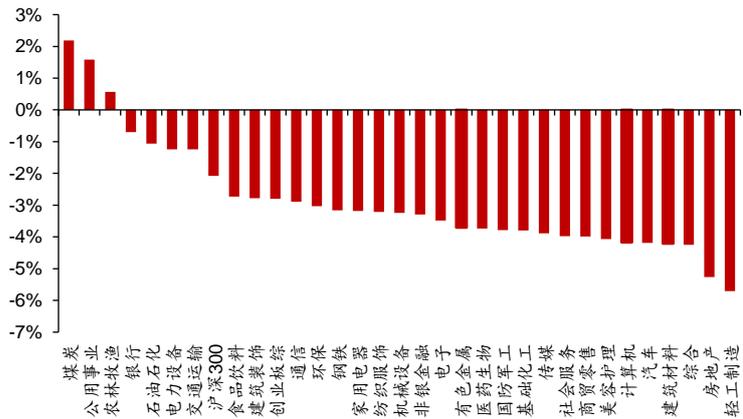
表 1: 电子板块 (SW) 个股过去一周涨跌幅前 10 名 (05.20-05.24) .....	5
表 2: 本周 A 股公司核心公告 (05.20-05.24) .....	8

# 1 市场回顾

## 1.1 板块表现

过去一周 (05.20-05.24), SW 电子指数下跌 3.49%, 板块整体跑输沪深 300 指数 1.41 pct、跑输创业板综指数 0.69 pct。在 31 个子行业中, 电子排名第 17 位。

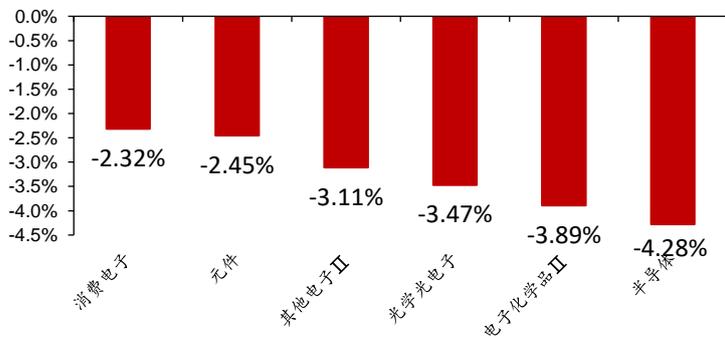
图 1: SW 一级行业周涨跌幅情况 (05.20-05.24)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

过去一周 (05.20-05.24) SW 电子二级行业中, 消费电子板块下跌 2.32%, 跌幅最小; 跌幅最大的是半导体板块, 下跌 4.28%。消费电子、元件、其他电子 II、光学光电子、电子化学品 II、半导体涨跌幅分别为 -2.32%、-2.45%、-3.11%、-3.47%、-3.89%、-4.28%。

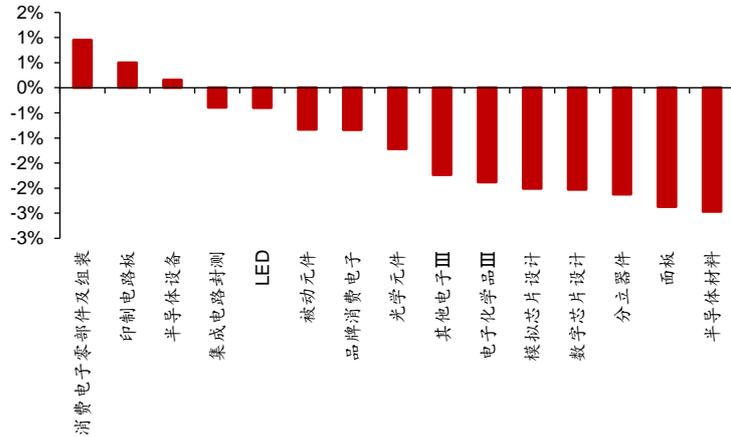
图 2: SW 电子二级行业周涨跌幅情况 (05.20-05.24)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

过去一周 (05.20-05.24) SW 电子三级行业中, 消费电子零部件及组装板块上涨 0.95%, 涨幅最大; 涨跌幅排名后三的板块分别为半导体材料、面板以及分立器件板块, 涨跌幅分别为 -2.46%、-2.37%、-2.12%。

图 3: SW 电子三级行业周涨跌幅情况 (05.20-05.24)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

## 1.2 个股表现

过去一周 (05.20-05.24) 涨幅前十的公司分别是英力股份 (80.20%)、隆扬电子 (57.24%)、雷曼光电 (35.17%)、鸿富瀚 (31.29%)、奕东电子 (23.28%)、创益通 (21.80%)、凯旺科技 (21.13%)、凯华材料 (19.63%)、\*ST 贤丰 (16.00%)、飞荣达 (15.99%), 跌幅前十的公司分别是斯达半导 (-34.10%)、骏成科技 (-31.24%)、信濠光电 (-31.05%)、博硕科技 (-30.02%)、安克创新 (-26.54%)、\*ST 超华 (-22.60%)、力合微 (-20.10%)、惠威科技 (-18.05%)、沃格光电 (-16.42%)、商络电子 (-14.82%)。

表 1: 电子板块 (SW) 个股过去一周涨跌幅前 10 名 (05.20-05.24)

周涨幅前 10 名			周跌幅前 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周涨幅(%)
300956.SZ	英力股份	80.20%	603290.SH	斯达半导	-34.10%
301389.SZ	隆扬电子	57.24%	301106.SZ	骏成科技	-31.24%
300162.SZ	雷曼光电	35.17%	301051.SZ	信濠光电	-31.05%
301086.SZ	鸿富瀚	31.29%	300951.SZ	博硕科技	-30.02%
301123.SZ	奕东电子	23.28%	300866.SZ	安克创新	-26.54%
300991.SZ	创益通	21.80%	002288.SZ	*ST 超华	-22.60%
301182.SZ	凯旺科技	21.13%	688589.SH	力合微	-20.10%
831526.BJ	凯华材料	19.63%	002888.SZ	惠威科技	-18.05%
002141.SZ	*ST 贤丰	16.00%	603773.SH	沃格光电	-16.42%
300602.SZ	飞荣达	15.99%	300975.SZ	商络电子	-14.82%

资料来源: iFinD, 上海证券研究所

## 2 行业新闻

### 澜起科技 MRDIMM 二季度订单态势良好

5月20日，据澜起科技消息，由于支持 MRDIMM 的主流服务器 CPU 平台目前暂未上市，因此 MRDIMM 尚未开始在下游规模应用，还处于在云计算/互联网厂商规模试用阶段，由于一根 MRDIMM 标配一颗 MRCD 及 10 颗 MDB 芯片，且该套片价值量较高，已在 2024 年第一季度为公司带来超过人民币 2000 万元的销售收入，二季度订单态势良好。（资料来源：科创板日报）

### 2024Q1 联发科保持智能手机处理器市场第一

5月20日，据 Canalys 消息，2024 年第一季度，智能手机处理器厂商数据显示，联发科保持智能手机处理器市场第一位，全球市场份额为 39%，其出货量达 1.141 亿颗，同比增长 17%，其中小米、三星和 OPPO 是前三大贡献者，分别占联发科智能手机处理器出货量的 23%、20%和 17%。紫光展锐在前五大智能手机处理器厂商中增长最快，同比增长 64%，达到 2,600 万颗。得益于其主要合作伙伴传音在亚太、欧洲、中东非以及拉美地区等新兴市场的扩张，使得这些地区智能手机出货量均实现两位数的增长。（资料来源：Canalys）

### 2024 年底 HBM 投片量预估占先进制程比重 35%

5月20日，据 TrendForce 集邦咨询研究，三大原厂开始提高先进制程的投片，继存储器合约价翻扬后，公司资金投入开始增加，产能提升将集中在今年下半年，预期 1alpha nm（含）以上投片至年底将占 DRAM 总投片比重约 40%。其中，HBM 由于获利表现佳，加上需求持续看增，故生产顺序最优先。以各家 TSV 产能来看，至年底 HBM 将占先进制程比重 35%，其余则用以生产 LPDDR5（X）与 DDR5 产品。（资料来源：TrendForce 集邦咨询）

### 受 HPC 和生成式 AI 推动，2029 年先进封装市场将增长至 695 亿美元

据市场研究机构 Yole Group 的数据显示，2023 年第四季度全球先进封装市场收入环比增长 4%至 107 亿美元。2023 年全年的先进封装市场营收约为 378 亿美元。尽管 2023 年需求持续疲软且客户库存持续消化，但有迹象表明 2024 年先进封装市场将恢复增长。从长期来看，得益于移动和消费、电信和基础设施以及汽车行业推动，以及 HPC 和生成人工智能等大趋势的推动，预计 2024 年

全年先进封装市场营收将同比增长 9.5%至 414 亿美元，预计到 2029 年将进一步增长到 695 亿美元，2023 年至 2029 年间的年复合增长率将达到 10.7%。（资料来源：芯智讯）

### 士兰微 8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议签署

5 月 21 日，士兰微公告，拟与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司共同向子公司厦门士兰集宏半导体有限公司增资 41.5 亿元并签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》，产能规模 6 万片/月，其中第一期项目总投资 70 亿元；第二期投资 50 亿元。第二期建成后新增 8 英寸 SiC 芯片 2.5 万片/月的生产能力，与第一期的 3.5 万片/月的产能合计形成 6 万片/月的产能。（资料来源：财联社）

### 预期 NAND Flash 合约价到第 224Q3 仍有季增双位数百分比的幅度

5 月 22 日，存储模组大厂威刚威刚表示，存储市场涨价趋势维持，预期 NAND Flash 合约价到第三季仍有季增双位数百分比的幅度、第四季则收敛至高个位数到中个位数百分比；而 DRAM 价格第三季应季增 10%~15%、第四季则为高个位数百分比。威刚强调，因其在去年存储价格相对低点时精准建置库存，将持续发挥低价库存利益，第二季毛利率可望续写新高。（资料来源：科创板日报）

### 专注电源管理 IC 和 BCD 制程，力积电将扩大 SLC NAND 产能

5 月 22 日，力积电表示，公司已调整产销策略，预期 2024 年营收将逐步回升。目前正持续调整产品线投资策略，开拓 BCD 制程，以争取电源管理 IC、物联网、AI、高速运算等相关商机。同时也扩大 SLC NAND Flash、NOR Flash 产能抢攻网通、移动通讯、PC 周边及物联网市场。此外，还开发了 WoW 技术，准备进军高带宽低功耗存储解决方案市场。（资料来源：科创板日报）

### OPPO Reno12 系列发布，售价 2699 元起

5 月 23 日，OPPO Reno12 系列发布，搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片和天玑 8250 星速版旗舰芯片，并首次支持“实况照片”功能。在 AI 应用方面，OPPO Reno12 系列新增“路人消除”、AI 抠图、AI 闭眼修复等功能，其中，小布旅行助理基于 OPPO 与百度地图的合作，联合推出业界首个 AI 出行大模型合作。（资料来源：科创板日报）

### 2024Q1 中国智能手机市场回暖，华为重回首位

5月24日，据Canalys消息，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。OPPO Reno 11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台。另一方面，荣耀，vivo，苹果在去年第四季度的积极出货后放缓节奏，分别排名第三、第四和第五。荣耀以1060万台的出货量位居第三，同比增长9%；vivo以1030万台的出货量紧随其后，出货同比下滑9%；苹果在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。（资料来源：Canalys）

## 3 公司公告

**表 2：本周 A 股公司核心公告（05.20-05.24）**

公告日期	公司	公告类型	要闻
2024-05-21	海光信息	股份回购	2024年5月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份675,500股，占公司总股本2,324,338,091股的比例为0.03%，回购成交的最高价为75.12元/股，最低价为73.24元/股，支付的资金总额为人民币49,983,654.59元（不含交易佣金等交易费用）。
2024-05-22	东山精密	权益分派	以公司现有总股本剔除已回购股份8,591,118股后的1,701,276,209股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利425,319,052.25元，不送红股，不以公积金转增股本。
2024-05-23	领益智造	权益分派	公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。
2024-05-23	翰博高新	对外投资	公司同意子公司博晶科技与雅南科技签署《合作经营协议》，以设立子公司的形式共同投资服务器总装制造业务，其中博晶科技投资2.6亿元，雅南科技投资2.4亿元，合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金或自筹资金。
2024-05-24	鸿日达	股份回购	截至2024年5月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,939,438股，占公司目前总股本的0.94%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为15.30元/股，成交总金额为35,980,387.34元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案回购期限已经届满，回购股份方案已实施完毕，实施情况符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
2024-05-24	晶合集成	股份回购	截至2024年5月22日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份40,155,756股，占公司总股本2,006,135,157股的比例为2.00%，与上次披露数相比增加0.58%，回购成交的最高价为15.31元/股，最低价为12.97元/股，支付的资金总额为人民币570,950,811.31元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

资料来源：iFind，上海证券研究所

## 4 风险提示

### 1) 中美贸易摩擦加剧

中美贸易摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，部分公司的经营或受到较大影响。

### 2) 终端需求不及预期

下游终端需求不及预期，产业链相关公司业绩或发生较大波动。

### 3) 国产替代不及预期

国产替代不及预期，国内企业的业绩或将面临承压。

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

### 公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

### 投资评级体系与评级定义

<b>股票投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
<b>行业投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

#### 投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

### 免责声明

本报告仅供上海证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。